

各 位

ホーチミン工科大学と技術交流 ～「技術交流に関する同意書」及び「インターンシップ覚書 (MoU)」を締結～

当社は、平成 26 年 12 月 19 日、ベトナム社会主義共和国のホーチミン工科大学 (HCMUT) との「技術交流に関する同意書」および「インターンシップ覚書 (MoU)」の締結を、ホーチミン工科大学 (HCMUT) 土木工学部学部長 N. M. TAM 氏、地盤試験室長 L. B. VINH 氏、ASEAN 工学系高等教育ネットワークプロジェクト (以下 AUN/SEED-Net) 小林氏、当社地盤技術部長 深澤、シンガポール事務所長 志賀の立会いのもと、同大学にて行った。

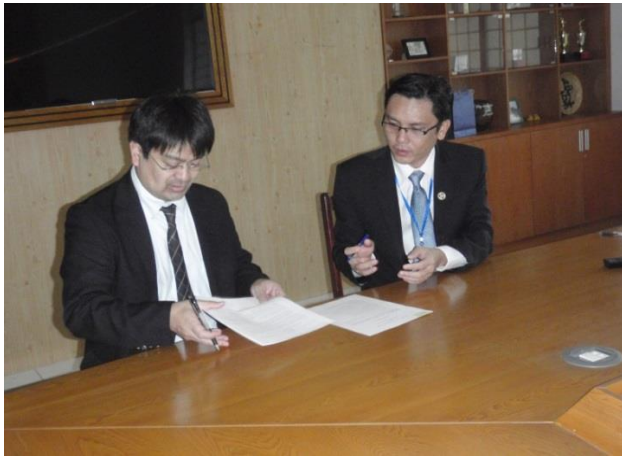
ホーチミン工科大学 (HCMUT) との間において締結した「技術交流」は、今後 5 年間にわたり、一次の通り実施する。

- ① HCMUT の学部関係者、研究者と ATK の技術者の交換プログラム
- ② HCMUT 学生の ATK へのインターンシップ
- ③ ワークショップの開催及び共同研究の開始
- ④ 学術文書、論文および情報の交換

締結セレモニー後、関係者間で「技術者交流」や「インターンシップ」および「ワークショップ」の内容について協議を行い、「インターンシップ」は 2 月、「技術者交流」と「ワークショップ」は 5 月に実施することで合意した。

この度の、ホーチミン工科大学との技術交流は、JICA AUN/SEED-Net の協力により実現した。AUN/SEED-Net は、ASEAN 10ヶ国における各国 中核大学の教育・研究能力の向上、工学系人材の育成及び日本-ASEAN 各国の アカデミックネットワークを確立することを目的とした JICA (独立行政法人国際協力 機構) が支援するプロジェクトである。

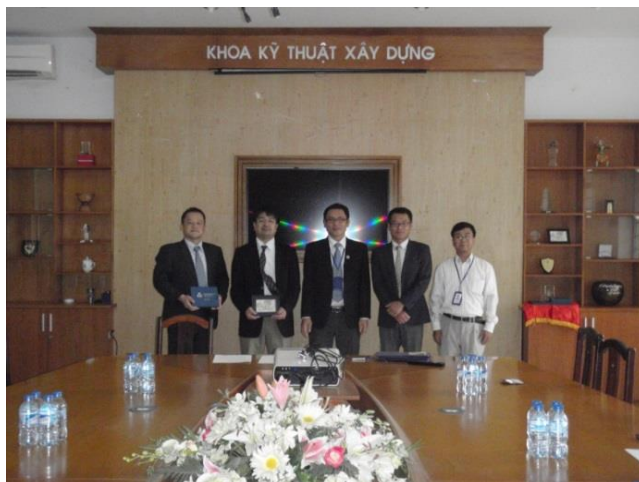
今回の様に、AUN/SEED-Net を通じて知り合った両組織が、覚書 (MoU) を交わすなど具体的な進展をみたケースは初めての試みとのことである。



【同意書、覚書にサインをする深澤、Dr. N. M. T】



【Dr. N. M. T より記念品の贈呈】



【左より 小林氏(JICA)、深澤、Dr. N. M. T、志賀、Dr. L. B. VINH】